上海立凯电控科技有限公司
Shanghai LineKey Technology Co., Ltd.

RoHS Compliance
Cd:Max.0.01wt%
Others:Max.0.1wt%

Specification For Approval
规 格 书

客 户 名 称 ：	
客 户 料 号 ：	
部 件 名 称 ：	BMS 变压器
立 凯 料 号 ：	LKBMT10C
项 目 编 号 ：	
承 认 编 号 ：	
版 本 号 ：	V0.1
日 期 ：	2024/6/24

LK Approval			Customer Approval
制 作	审 核	核 准	
李 成 坤	/	赵 建 平	

Please Return One Copy to Us After Approved,TKS! (承认后请回寄一份,谢谢)

ADD（地址）： 上海市闵行区陈行公路2388号7号楼8B
Room 8B, Building 7, No.2388 Chenhang Road, Minhang District, Shanghai
TEL（电话）： 021-61993616
Web（网址）： www.linekey.cn
E-mail（邮箱）： sales@linekey.cn

立凯料号：	LKBMT10C	版本号：	V0.1
承认编号：		页码:	1/5

修订记录

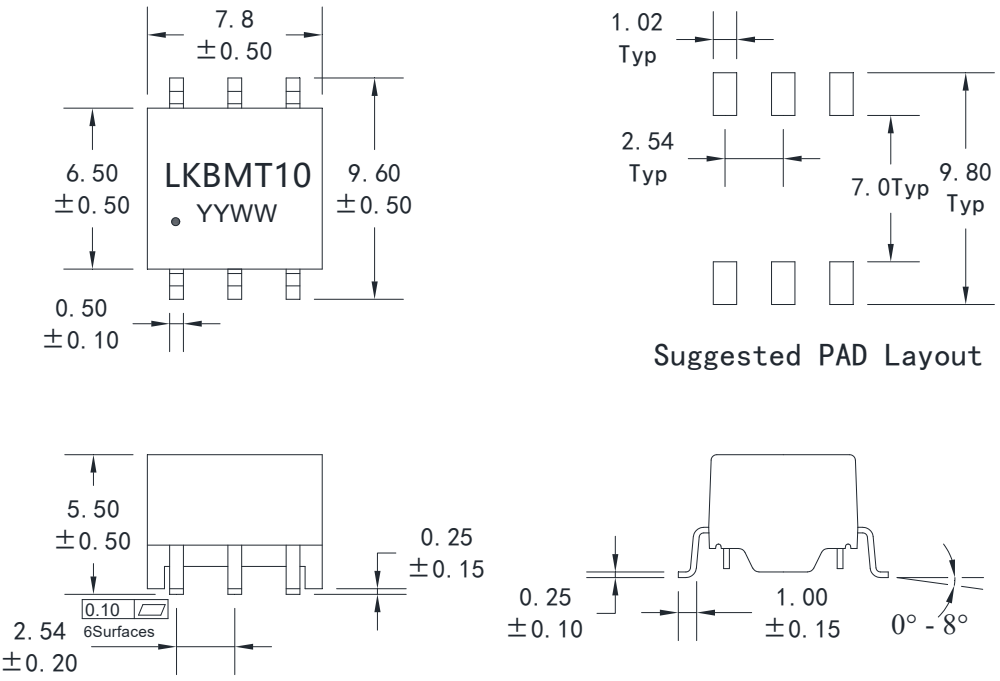
版本	修订时间	修改人	变更原因
V0.1	2024/6/24	李成坤	新版发行

拟制/PREPARED BY:	审核/CHECKED BY:	批准/RATIFYIED BY:
李成坤	/	赵建平

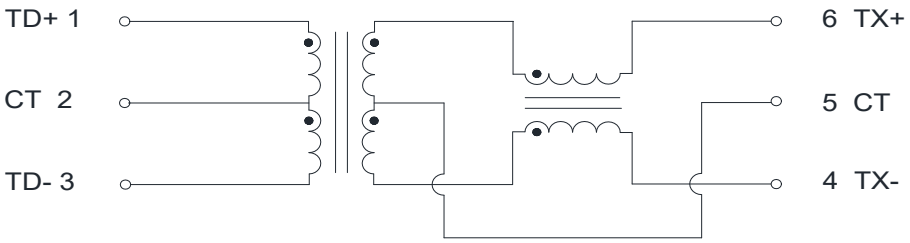
A. 产品特征

1. 符合IEC 60664-1和IEC 62368-1规范，满足功能绝缘
2. 工作温度范围：-40°C~125°C(含自升温)
3. 储存温度范围（含包装）：-10℃～+40℃
4. 符合ROHS标准

B.结构尺寸 (Unit: mm)



C.电路图

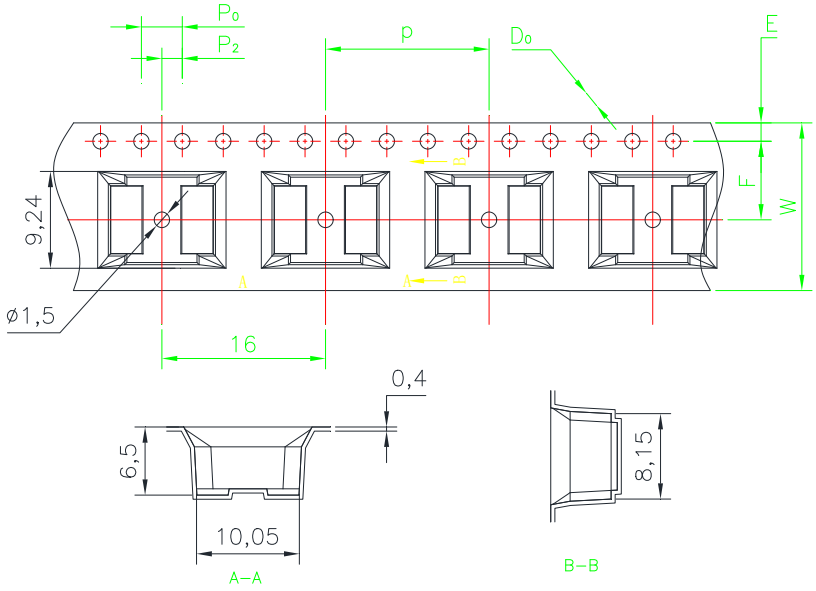


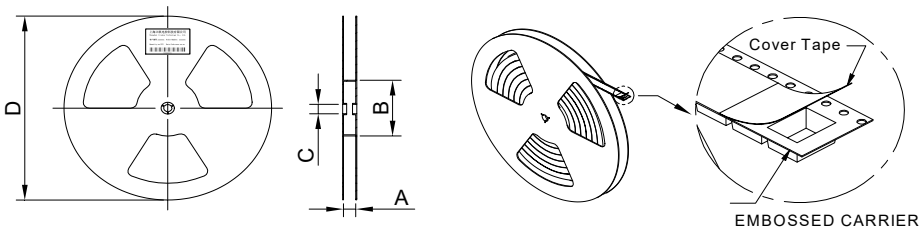
D. 电气规格 @25℃

项目	测试脚位	测试规格	单位	测试条件
电感	1-3	150 Min	uH	100KHz,0.1V
圈比	(1-3):(4-6)	1:1±3%	/	100KHz,1V
漏感	1-3(4-6shorted)	0.5 Max	uH	100KHz,0.1V
直流电阻	1-3	0.7 Max	Ω	AT 25±5℃
	4-6	1.0 Max	Ω	
初次级耐压	Pri(1-3)to Sec(4-6)	No breakdown	/	4300VDC/1mA/60S 3100VAC/1mA/2S
插入损耗	(1-3)-(4-6)	-0.5 Max	dB	4MHz
回波损耗	(1-3)-(4-6)	-20 Min	dB	4MHz
共模抑制比	(1-3)-(4-6)	-35 Min	dB	1-100MHz

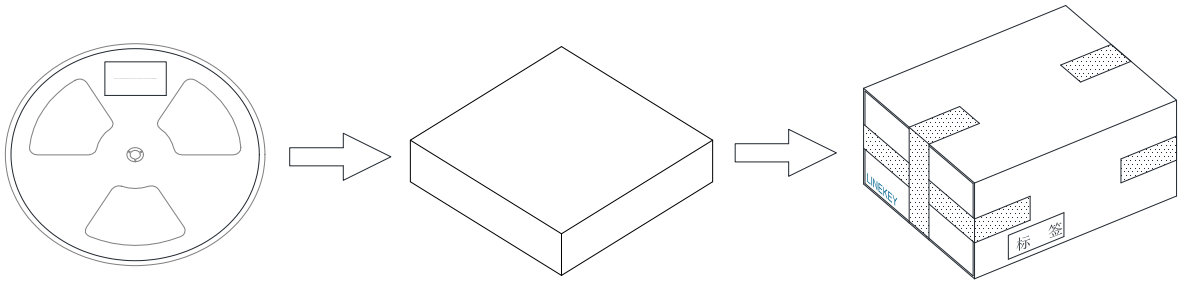
E. 包装信息

尺寸栏	
E	1.75±0.10
F	7.50±0.10
P2	2.00±0.10
ØDo	$1.50^{+0.10}_{-0.00}$
ØD1	1.50±0.10
Po	4.00±0.10
10Po	40.00±0.20
W	16.00±0.30
P	16.00±0.10
Ao	10.05±0.10
BO	8.15±0.10
KO	6.50±0.10
t	0.40±0.05





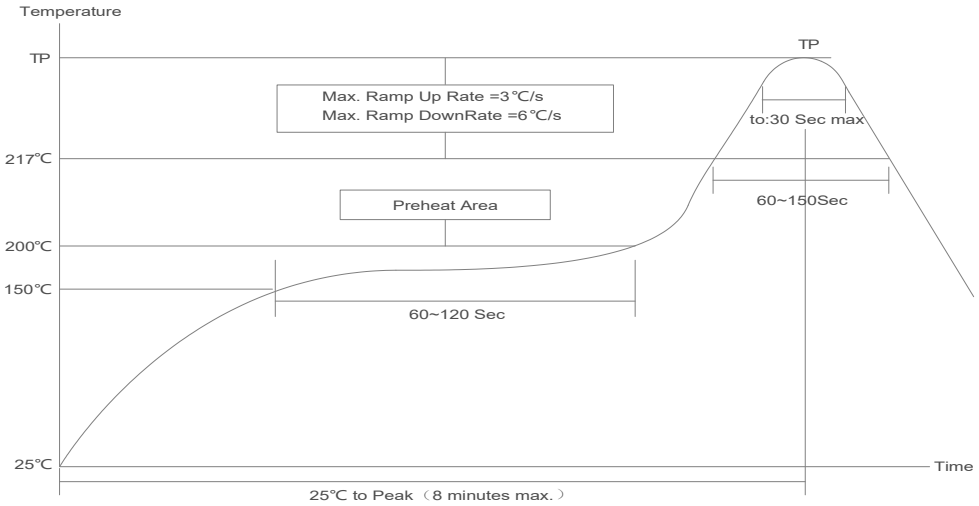
A	B	C	D
24.4+2/-0	100±2	13+0.5/-0.2	330



600pcs/Reel　　4 Reels/Inner Carton　　2 Inner Carton/Carton box(4800 pcs)

拟制/PREPARED BY:	审核/CHECKED BY:	批准/RATIFYIED BY:
李成坤	/	赵建平

F. 推荐回流焊接曲线



Reflow Parameter	Specification
Preheat temperature(Tsmin-Tsmax)	150℃-200℃
Preheat Time(ts)	60-180 seconds
Ramp-up Rate(TL-Tp)	3℃/second maximum
Time Above 217℃(TL)	60-150 seconds
Peak Temperature(Tp)	see Table 2
Time Within 5℃ of Peak(Tp)	20-40 seconds
Ramp-down Rate(Tp-TL)	6℃/second maximum
25℃ to Peak Temperature(T to Tp)	8minutes maximum

*Table adapted from JEDEC Standard IPC/JEDEC J-STD-020D.

回流焊参照标准 IPC/JEDEC J-STD-020E

封装厚度	封装体积		
	<350 mm^3	350~2000 mm^3	>2000 mm^3
<1.6mm	260℃	260℃	260℃
1.6~2.5mm	260℃	250℃	245℃
≥2.5mm	250℃	245℃	245℃